

配線用熱硬化型銅ペースト

Heat Curing Type Copper Paste for Electronic Circuits ELTRACE[®] CP-602AA/CP-902GA

特長 Features

- スクリーン印刷により電子回路形成可能
Electronic circuits can be formed by screen printing.
- 大気下、低い硬化温度で硬化が可能
Curable at low temperature under air.
- 硬化膜配線はマイグレーション耐性が良好
High migration resistance.
- はんだによる部品実装が可能(CP-902GA)
Electronic components can be mounted using solder.



ELTRACE[®] CP外観
Appearance of ELTRACE[®] CP



包材例(アルミチューブ)
Packaging example
(Aluminum tube)

一般特性 General Properties

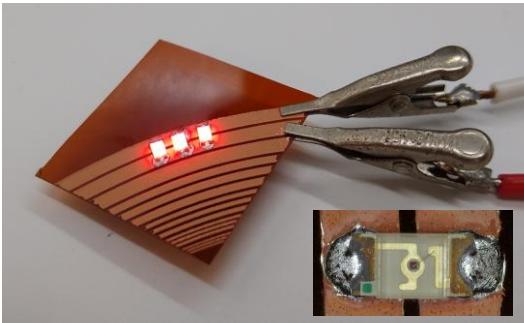
Item		ELTRACE [®] CP-602AA	ELTRACE [®] CP-902GA
Curing Condition	Temperature(°C)	150	170
	Time(min)	15	15
	Atmosphere	Air	Air
Properties	Viscosity (Pa・s)	30	100
	Adhesion (Cross cutting) Substrate: FR4、PET etc.	100/100	100/100
	Volume Resistivity ($\mu\Omega \cdot \text{cm}$)	20	60
	Wettability for Solder	×	○

適用例 Examples of Application

- 電子回路の直接形成
Direct formation of electronic circuits.
- センサーの電極形成
Sensor electrode formation.



スクリーン印刷例
Example of screen printing
SUS400 mesh squeeze speed: 50 mm/s



デバイス実装例
Example of LED device with
ELTRACE[®] CP-902GA and solder

本資料に記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。
エルトレース、ELTRACEは日油株式会社の登録商標です。

The data listed in this leaflet are typical values and not guaranteed values.
ELTRACE is a registered trademark of NOF CORPORATION.